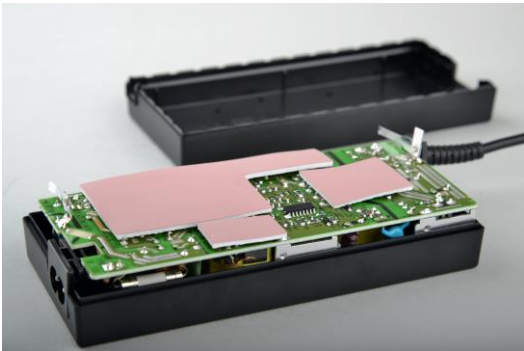


UTPI00-H30-9

复合导热垫片

UTPI00-H30-9是使用硅胶与导热陶瓷填料，以玻璃纤维布为补强材料，经特殊工艺加工而成。具单面自粘型，防刺穿，抗击电压增强，是一款非常柔软，具有优异的可压缩性的导热硅胶垫片，可与电子元器件紧密接触，有效降低界面热阻，导热性能表现极佳。在-40℃~150℃可以稳定工作，同时满足UL94 V-0等级阻燃要求，



特性和优点

- 导热系数1.0W/m.k
- 超柔软、高压缩可至50%
- 单面自粘
- 玻纤布增强材料强度，可冲孔不变形
- 高电气绝缘

典型应用

- LED照明设备
- 功率转换设备
- 平面显示器
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 高电气绝缘要求的MOS管

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	棕红+白色	目视
厚度(mm)	0.5~12.0	ASTM D374
密度(g/cc)	1.9	ASTM D792
硬度(Shore OO)	30	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	2.5	ASTM D412
延伸率(%)	60	ASTM D412
重量损失(%)	≤1	滤纸吸附@压缩25%125℃48H
耐温范围(℃)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度 < 40℃避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV)@0.5mm	≥8	ASTM D149
介电常数 (1000Hz)	5.3	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	≥10 ¹³	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/m-K)	1.0	ISO 22007-02